



台積公司、博世、英飛凌和恩智浦半導體成立合資公司

在歐洲引入先進半導體製造

發佈單位：台灣積體電路製造股份有限公司、羅伯特博世公司、英飛凌科技股份有限公司、恩智浦半導體

發佈日期：2023年8月8日

台灣積體電路製造股份有限公司、羅伯特博世公司（Robert Bosch GmbH）、英飛凌科技股份公司（Infineon Technologies AG）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.）今（8）日宣佈，有計劃將共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司（European Semiconductor Manufacturing Company, ESMC），以提供先進半導體製造服務。ESMC代表著300mm晶圓廠興建計畫邁出了重要的一步，支援汽車和工業市場中快速成長的未來產能需求，其最終投資定案尚待政府補助水準確認後決議。此計畫依據《歐洲晶片法案》（European Chips Act）的框架制定。

此計畫興建的晶圓廠預計採用台積公司28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體（CMOS），以及16/12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程技術，月產能約40,000片300mm（12吋）晶圓。藉由先進的FinFET技術，將能進一步強化歐洲半導體製造生態系統，且創造約2,000個直接的高科技專業工作機會。ESMC目標於2024年下半年開始興建晶圓廠，並於2027年底開始生產。

籌備中的合資公司經監管機關核准並符合其他條件後，將由台積公司持有70%股權，博世、英飛凌和恩智浦則各持有10%股權。透過股權注資、借債，以及在歐盟和德國政府的大力支持下，總計投資金額預估超過100億歐元。該晶圓廠將由台積公司營運。

台積公司總裁魏哲家博士表示：「本次在德勒斯登的投資展現了台積公司致力於滿足客戶策略能力和技術需求的承諾，我們很高興有機會加深與博世、英飛凌和恩智浦半導體的長期合作夥伴關係。歐洲對於半導體創新來說是個大有可為之地，尤其是在汽車和工業領域方面，我們期待與歐洲人才攜手，將這些創新引入我們的先進矽技術中。」

博世集團董事會主席 Dr. Stefan Hartung 表示：「半導體不僅是博世成功的關鍵，其可靠的可取得性對於全球汽車產業的成功也至關重要。博世不僅持續擴大我們自有的製造設施，做為汽車供應商，我們亦透過與合作夥伴的密切合作來進一步鞏固汽車供應鏈。我們很高興能爭取到與台積公司這樣的全球創新領導者攜手，以強化德勒斯登半導體晶圓廠周邊的半導體生態系統。」

英飛凌執行長 Jochen Hanebeck 表示：「我們的共同投資對支持歐洲半導體生態系統而言是一重要里程碑，這項計畫強化了德勒斯登作為全球最重要半導體樞紐之一的地位，而此地更早已是英飛凌最大的前端製程據點所在。英飛凌將利用此全新產能滿足不斷成長的需求，尤其針對汽車和物聯網領域的歐洲客戶。先進的製造能力將為開發創新技術、產品和解決方案提供基礎，以應對低碳化（decarbonization）和數位化（digitalization）等全球性挑戰。」

恩智浦半導體總裁兼執行長 Kurt Sievers 表示：「恩智浦半導體非常致力於強化歐洲的創新和供應鏈彈性，我們感謝歐盟、德國和薩克森自由邦認可半導體產業的關鍵角色，並對推動歐洲晶片生態系統做出實際承諾。這個嶄新且標誌性的半導體晶圓廠建設，將為因急劇增加的數位化和電氣化而需要各式矽製品的汽車和工業領域，提供所需的創新和產能。」

關於博世

博世集團為全球科技及服務的領導廠商。截至 2022 年 12 月 31 日，博世集團全球員工人數約為 42 萬 1 千人，2022 年博世集團營業額為 882 億歐元。博世擁有四大事業群：交通解決方案、工業科技、消費性產品，以及能源暨建築智能科技領域。身為物聯網領域的領導公司，博世提供智慧家庭、工業聯網和聯網交通等創新解決方案，旨在打造永續、安全和振奮人心的未來交通移動願景。

博世擁有在感測器科技、軟體與服務的專業，同時擁有自己的物聯網雲端系統，以單一窗口提供客戶聯網、跨域解決方案。博世集團的企業發展目標為透過包含人工智慧在內的創新與激發熱情的產品與服務，在全球創造聯網生活並提升生活品質。簡而言之，博世打造了“科技成就生活之美”的先進科技。集團包括羅伯特博世公司（Robert Bosch GmbH）及遍佈 60 多個國家的 470 多家分公司和區域性公司。若將其銷售和服務夥伴涵蓋在內，博世的業務幾乎遍及全球所有國家。自 2020 年第一季起，博世集團全球逾 400 個據點已達成碳中和。博世未來發展的基礎在於其創新能力，全球共有約 85,500 位研發人員，其中包含約 44,000 名軟體工程師，在 136 個據點進行研發相關的工作。詳情請見博世集團相關網站：www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.twitter.com/BoschPresse.

關於英飛凌

英飛凌科技股份有限公司是全球電源系統及物聯網半導體的領導廠商。英飛凌以其產品及解決方案驅動低碳化及數位化。英飛凌在全球擁有約 56,200 名員工，2022 會計年度（截至 9 月 30 日），公司營收約為 142 億歐元。

英飛凌於德國法蘭克福證券交易所（股票代碼：IFX）以及美國櫃檯買賣中心 OTCQX International Premier（股票代碼：IFNNY）掛牌上市。更多資訊請參考：www.infineon.com。亦可於 www.infineon.com/press 取得新聞稿資訊。追蹤英飛凌動態：[Twitter](#) - [Facebook](#) - [LinkedIn](#)

關於恩智浦半導體

恩智浦半導體 NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI) 彙集英才，共同創造突破性技術，為更智慧安全的互聯世界保駕護航。作為全球領先的嵌入式應用安全連接解決方案提供商，恩智浦不斷尋求汽車、工業物聯網、移動設備和通信基礎設施市場的突破，同時不斷推出解決方案，助力實現可持續發展的未來。恩智浦擁有超過 60 年的專業技術及經驗，在全球 30 多個國家設有業務機構，員工達 34,500 人，2022 年全年營業收入 132.1 億美元。更多資訊，請造訪：www.nxp.com。

關於台積公司

台積公司成立於 1987 年，率先開創了專業積體電路製造服務之商業模式，自此成為世界領先的專業積體電路製造服務公司。台積公司以領先業界的製程技術及設計解決方案組合支援其客戶及夥伴生態系統的蓬勃發展，以此釋放全球半導體產業的創新。身為全球的企業公民，台積公司的營運範圍遍及亞洲、歐洲及北美，致力成為企業社會責任的行動者。

2022 年，台積公司提供最廣泛的先進製程、特殊製程及先進封裝等 288 種製程技術，為 532 個客戶生產 1 萬 2,698 種不同產品。台積公司企業總部位於台灣新竹。進一步資訊請至台積公司網站 <https://www.tsmc.com.tw> 查詢。

#

博世新聞連絡人：

Athanassios Kaliudis

Spokesperson connected mobility, software and automotive electronics

Tel: +49 152 08651292

Email: athanassios.kaliudis@de.bosch.com

英飛凌新聞連絡人：

Andre Tauber

Head of Corporate Media Relations

Tel +49 89 234-36705

Email: Andre.Tauber@infineon.com

恩智浦半導體新聞連絡人：

Mike Silverman

Sr. Director of Global Public Relations

Mobile: +1 979-350-9210

Email: Mike.Silverman@nxp.com

台積公司代理發言人：

高孟華

企業公共關係處主管

Tel: +886-3-563-6688 ext. 712-5036

Mobile: +886-988-239-163

E-Mail: nina_kao@tsmc.com

台積公司新聞連絡人：

吳皓筠

企業公共關係處

Tel: +886-3-563-6688 ext. 712-5657

Mobile: +886-988-930-038

E-Mail: laura_wu@tsmc.com